

フリップチップボンド

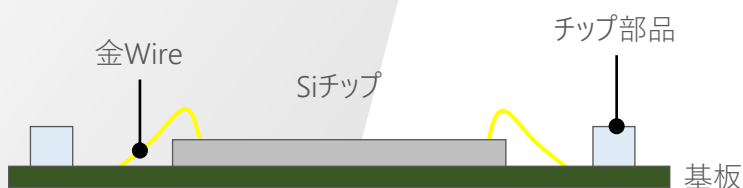
フリップチップボンディングとは

Siチップと基板を金Bumpによって実装することをフリップチップボンディングといいます。

従来の実装プロセスであったワイヤーボンディングと比べて、実装面積を小さくすることができます。

また配線が短いため、電気的特性が良いという利点もあります。

従来プロセス構造 (ワイヤーボンディング)



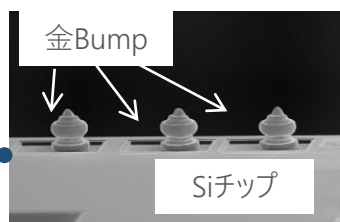
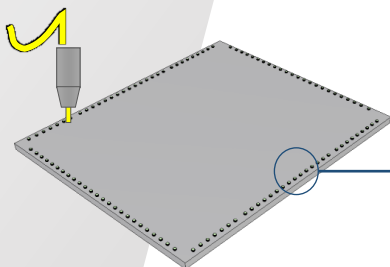
フリップチップボンディング構造



実装工程

1 バンプボンディング

Siチップ上に金Bumpを形成します

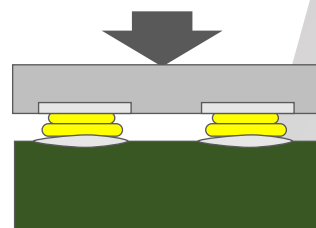
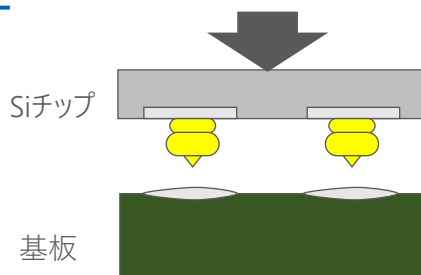
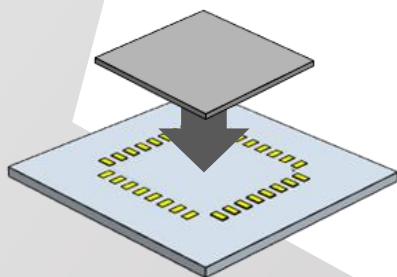


最大12インチ(300mm)までのウエハーまで対応可能です。

ベアウエハー、テープマウントウエハー、リコンウエハーに対応します。

2 フリップチップボンディング

Siチップと基板を超音波・圧力・熱を使って接合します



3 アンダーフィル

Siチップと基板の隙間に樹脂を注入することで、強度を上げます

